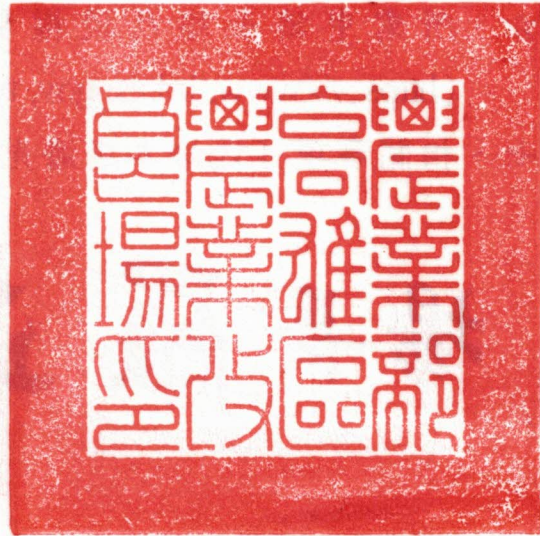


檔 號：
保存年限：

農業部高雄區農業改良場 公告

發文日期：中華民國114年7月11日
發文字號：農高改環字第1145532126號
附件：如文



主旨：公告本場研發成果「附掛式雷射整平器製造及裝配技術」
非專屬授權業界利用事宜。

依據：農業部農業智慧財產權審議會第21次會議決議。

公告事項：

- 一、本技術(授權資料如附件1)係本場執行113年科技產學合作計畫「開發附掛式田間雷射整平機械」成果，以非專屬授權方式移轉業者。授權生產及製造地區限我國管轄區域內，產品銷售出口地區不限，授權期限5年，授權金合作業者20萬元整，加計5%營業稅為21萬元整，非合作業者40萬元，加計5%營業稅為42萬元整。
- 二、申請資格：農會、農業合作社、公司及農業機械製造廠商。
- 三、申請日期：自公告日起接受申請。
- 四、申請業者需檢附資料：
 - (一)廠商基本資料表(附件2)。
 - (二)本場研究成果技術轉移意願書(附件3)。
 - (三)公司、行號或工廠等合法設立證明文件影本一份(法人及

農民團體免附)。

五、請案經本場研管小組審查通過後，雙方簽訂技術非專屬授權契約書(附件4)後辦理技術移轉。

六、所需申請表格及授權契約資料說明請逕由本場網站(<https://www.kdais.gov.tw>)公告下載。

七、相關事項可逕洽本場潘光月副研究員，電話(08)7746787。



場長羅正宗

訂

線